有机硅灌封胶
EncapSil 5202
序列号：XG2

一、产品概述

有机硅灌封胶 EncapSil 5202　XG2 是一种双组份室温缩合脱醇型有机硅灌封胶，适用于电子电器产品的灌封防护，可延长电子产品的使用寿命。使用时，按照比例混合均匀，经过一定时间后，固化成具有良好弹性的防护材料。

二、产品特性

1、双组份，混合重量比 10:1，室温固化快；
2、适用于静/动态混合机械灌封；
3、导热/电性能优异；
4、防水性能优异，耐候，耐高温高湿；
5、与大多数塑料，金属，玻璃，粘附性好；
6、通过 UL 阻燃认证；
7、符合欧盟 ROHS\REACH 法规
8、抗老化性能好，可在-40～150℃内长期保持橡胶弹性。

三、性能指标

测试项目	单位	参考标准	典型值
外观	——	目测	A 组分：灰色流体
			B 组分：半透明液体
粘度	mPa·s	GB/T 2794	A 组分：5200
			B 组分：27
混合流动性 [1]	mm	——	125
表干时间	h	GB/T 29595	3.5
初固化间	h	GB/T 29595	8
密度	g/cm^3	GB/T 533	1.65
硬度	Shore A	GB/T 531.1	54
导热系数	W/(m·K)	ISO 22007-2	0.62
击穿电压强度	kV/mm	GB/T 1695	22
体积电阻率	Ω·cm	GB/T 1692	5.0×10^{14}

注：取 AB 混合后胶料 20g 滴在玻璃板上，5min 后测量扩展开的胶料直径。

有机硅灌封胶
EncapSil 5202
序列号：XG2

四、应用领域

广泛应用于精密电子元器件、电子模块、电器模块、照明电器、电源和线路板等的灌封保护。

五、施工方法

1、将 A、B 两组分按重量比 10：1 称量，然后混合搅拌均匀，在操作时间内浇注到需灌封的产品上，如灌封产品过大，可采取分多次灌封的方式，然后根据上表所对应的固化条件固化即可；

2、胶料放置时间过长会产生沉淀，需在取用前先将 A、B 组分各自搅拌均匀，然后再混合，取用后应注意密封保存，尤其是 B 组分。

3、搅拌时，应该注意同方向搅拌，否则会混入过多的气泡；容器边框和底部的胶料也应搅拌均匀，否则可能会出现局部不固化现象。

4、灌封到产品上后再次抽真空排泡，可提高产品固化后的综合性能。

5、该产品的固化速度会由于温度和湿度的不同而发生变化，在不同的地域和季节都应当提前对收到的产品进行固化速率测试，以便更好地符合现场工艺；请在初次使用此系列产品时，咨询我司技术人员产品特性和生产工艺建议。

六、包装规格

A：20 千克/桶；
B：2 千克/壶，8 壶/箱

七、储存及运输

1、需避光、避热、密封储存；

2、阴凉干燥处，可储存 6 个月。

八、有限保证信息

此处提供的信息与我们的实践经验一致。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为安全、有效并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。本产品资料不能被视为完整的资料，本公司对此不承担任何义务，同时也不对第三方提出的索赔要求负任何义务。